

半導体ウェットプロセスエッチングおよび基板搬送用のカスタマイズ可能な正方形Ptfеシリコンウェハークリーニングフラワーバスケット

商品番号: PL-CP88



前書き

シリコンウェハークリーニング用に設計された高純度PTFE製正方形クリーニングフラワーバスケット。この耐食性ラックは、半導体製造における安全なウェットエッチングと基板搬送を保証します。特定のラボラトリーや産業用ウェットベンチの要件に合わせて、寸法や構成を完全にカスタマイズ可能です。

詳細を学ぶ

用途	説明	主なメリット
半導体製造	不純物を除去するため、RCAクリーニングまたはピラニアエッチング溶液にシリコンウェハークリーニングバスケットを浸漬します。	金属汚染のリスクがゼロ
太陽電池製造	テクスチャ形成および酸研磨工程中の大型太陽電池ウェハークリーニングバスケットの搬送。	高いスループットと耐久性
MEMSデバイス処理	様々なウェットベンチを通じて繊細なマイクロエレクトロメカニカル基板を安全に輸送します。	精密な基板位置決め
LCD/OLEDガラスクリーニング	薄膜堆積前の導電性ガラス基板（ITO/FTO）のクリーニング。	ガラスクリーナーに対する耐薬品性
高純度ラボラトリーリサーチ	微量分析および攻撃的な化学分解プロセス中のサンプルの保持。	腐食性媒体に対する優れた耐性
ナノテクノロジー基板	研究環境におけるシリコンオンインシュレーター（SOI）またはサファイアウェハークリーニングバスケットの処理。	脆い材料の優しい取り扱い

仕様カテゴリ	PL-CP88のパラメータ詳細
型番	PL-CP88
主材料	高純度ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）
標準寸法	249mm x 249mm（ご要望によりカスタムサイズ対応可能）
形状	正方形フレームフラワーバスケットデザイン
カスタマイズオプション	スロット数、スロット幅、スロット深さ、ピッチ、およびハンドルスタイル
動作温度範囲	-200°C ~ +260°C
耐薬品性	汎用性（溶融アルカリ金属および高圧フッ素を除く）
製造方法	高公差仕様のためのエンドツーエンドの精密CNC加工
表面仕上げ	滑らかで多孔質のないフッ素重合体仕上げ
互換性	手動浸漬浴および自動ロボットウェットベンチアーム